ビット間交換結合を有するビットパターン媒体の磁気特性 Magnetic properties of bit-patterned media with exchange coupling between bits

<u>近藤 祐治</u>^a, 有明 順^a, 千葉 隆^a, 田口 香^a, 鈴木 基寬^b, 河村 直己^b, 本多 直樹^c Yuji Kondo^a, Jun Ariake^a, Takashi Chiba^a, Kaori Taguchi^a, Motohiro Suzuki^b, Naomi Kawamura^b, Naoki Honda^c

^a秋田県産業技術総合研究センター,^b高輝度光科学研究センター,^c東北工業大学 ^aAkita Research and Development Center,^bJASRI,^c Tohoku Institute of Technology

1 Tbit/in² 以上で顕著になる静磁気相互作用に起因するスイッチング磁界分散(SFD)を低減する手法と してビット間交換結合を導入することを提案した.ビット間交換結合の導入はビット転写プロセスに おいてエッチング時間を変えることでビット間の残膜厚を制御し交換結合を有する磁性ドットアレ イを作製した.このようにして作製したドットアレイの ESMH 測定をした結果,残膜厚が厚くなるに つれて,SFD が減少することが明らかになり,ビット間交換結合の導入が有効であることがわかった.

Increase in switching field distribution (SFD) deteriorates write-ability significantly of the recording head, especially in an areal density of 1 Tbit/in² and beyond. Therefore, the exchange coupled BPM between the dots was proposed as a technique to reduce the SFD. The exchange coupling was controlled with the residual film thickness between the dots. ESMH curves of the dot arrays with various exchange coupling strength were obtained by XMCD. As the residual film thickness between the dots between the dots between the key became thick, the SFD became small. The exchange coupling could be successfully controlled by the residual film thickness between the dots in the milling process. The introduction of the coupling is effective to reduce the magnetostatic interaction effect in bit-patterned media.

キーワード:ビットパターン媒体,スイッチング磁界分散,ビット間交換結合,顕微磁気円二色性

背景と研究目的: ハードディスクに代表され る磁気記録装置の次世代方式として、ビットパ ターン媒体(BPM)が有力視されている.この パターン媒体では、人工的に磁性ドットを周期 的に配列して、その一つのドットに1ビットを 記録することにより、熱安定性の確保と記録磁 界の低減を両立でき、1 Tbit/in²以上の面記録密 度が達成できると期待されている.そこで,我々 はこれまでに 1 Tbit/in² 級の面記録密度に相当 する磁性ドットを作製する手法として,低エネ ルギーイオンによるエッチングを用いることに よって,磁気的ダメージの少ない磁性ドットア レイの作製が可能であることを示してきた[1]. また, この作製手法を用いて, 1 Tbit/in²級の磁 性ドットアレイの作製と磁気特性評価について も世界に先駆けて報告してきた[2]. しかしなが ら, BPM を使ってとしても, 1 Tbit/in²以上の記 録密度においてはドット間の静磁気相互作用の ためにスイッチング磁界分散(SFD)が大きくな り、記録性能と熱安定性の両立が困難になるこ とが問題視されている.SFDを低減する手法の 一つとして、ビット間交換結合の導入により2 Tbit/in²の面記録密度が実現できることがシミ ュレーションにより示されている[3].本研究で

は、交換結合を有する Co-Pt ドットアレイの作 製と磁気特性の検討を行った.

実験: Co-Pt膜はマグネトロンスパッタ法によ り成膜し,記録層はCo₈₀-Pt₂₀(7 nm)とした.磁性 ドットアレイは電子線描画とArイオンミリン グを用いてパターニングした.電子線レジスト にはカリックスアレンを用いて,加速電圧50 kV, ビーム電流50 pAの条件で描画を行った. Co-Pt 膜へのパターン転写は,磁気的ダメージを軽減 するために200 eVの低エネルギーArイオンでエ ッチングを行った.パターンサイズは1 Tbit/in² に相当するドット径17 nm,ドットピッチ25 nm とした (Fig. 1). 交換結合の強さは,エッチン

(a) Before etching	(b) After etching
and the second se	

	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.2 µm 100000X	0.2 µm 100000X

Fig. 1. Scanning electron microscope image of CoPt dot arrays with a dot diameter of 17 nm and periods of 25 nm.



Fig. 2. ESMH curves of 25 nm-period CoPt dot arrays with various residual film thickness (upper) and switching probability evaluated by differentiating the ESMH curves (bottom).

グ時間を変えてドット間のCo-Pt残膜厚を変化 させることで制御し,本研究では残膜厚を0.05, 0.35, 1.25 nmと変化させた3種類の試料を作製 した. XMCD測定はBL39XUのKirkpatrick-Baez ミラーを備えたmicro-XMCDシステム[4]を用い, Pt L_3 端での蛍光法により行った. X線ビーム径 は2.6 (H) × 3.3 (V) μ ²であった. 磁場はマイク ロビーム用電磁石により,試料面に対して垂直 方向に最大12 kOe (ポールピースギャップ6 mm)を印加した.

結果と考察: Fig. 2 上図に 25 nm ピッチ Co-Pt ドットアレイの Pt L3 吸収端における ESMH 曲 線を示す. 図中の黒丸,赤丸,青丸はそれぞれ 残膜厚 0.05, 0.35, 1.25 nm のドットアレイに対 応する. 残膜厚が厚くなるにつれて ESMH 曲線 の保磁力(H_c)付近の傾きが大きくなっているの がわかる.これは残膜厚を厚くしたことによっ て、ビット間の交換結合が増加したためと考え られる. 次に ESMH 曲線から SFD を求めるた めに, ESMH 曲線を微分し, ガウス関数フィッ ティングした結果を Fig. 2 の下図に示す. この フィッティング結果から標準偏差oHsw を求め, H_{c} で規格化したものを SFD($\sigma H_{SW}/H_{c}$)と定義し た. Fig. 3 に SFD の残膜厚依存性を示す. 残膜 なしの場合には15%程度のSFDが残膜厚を厚 くしてドット間交換結合を導入することによっ て、5%程度のSFDまで減少できることがわか った.また,交換結合磁界(He)を変えたドット



Fig. 3. Switching field distributions of CoPt dot arrays as a function of residual film thickness.

アレイに対する磁化曲線をマイクロマグネティ ック計算により求めた結果,交換結合が強いほ ど SFD は小さくなり, Fig. 3 の実験結果と同様 な結果が得られた.以上の結果より,ビット間 交換結合はミリング時間により制御でき,それ により SFD を減少できるため,ビット間交換結 合の導入は 1 Tbit/in² 以上の記録密度において 熱安定性と記録性能を両立する手段として有効 であることがわかった.

今後の課題: 今回の実験から,ドットの反転 磁界分散(SFD)を低減する手法として,ビット間 交換結合の導入が有効であることが明らかにな ったため,今後はより実際の実用媒体の系に近 い構造のビットパターン媒体作製を行い,その 磁気特性評価からビット間交換結合導入の有用 性を示していく予定である.

謝辞: 本研究は文部科学省科学研究費補助金 (若手研究(B)課題番号 19760243)および NEDO グリーン IT プロジェクト(富士通株式会 社からの再委託)の補助を受けて実施されたも のである.

参考文献

1) Y. Kondo, T. Chiba, J. Ariake, K. Taguchi, M. Suzuki, M. Takagaki, N. Kawamura, B. M. Zulfakri, S. Hosaka, N. Honda, *J. Magn. Magn. Mater.*, **320** (2008) 3157.

2) Y. Kondo, J. Ariake, T. Chiba, K. Taguchi, M. Suzuki, N. Kawamura, N. Honda, Digests of Intermag 2009 (Sacramento), CP-03, 2009.

3) N. Honda, K. Yamakawa, K. Ouchi, *IEEE Trans. Magn.*, **43**, 2142 (2007).

4) M. Suzuki, M. Takagaki, Y. Kondo, N. Kawamura, J. Ariake, T. Chiba, H. Mimura, T. Ishikawa, *AIP Conference Series*, **879** (2007) 1699.